芯联集成电路制造股份有限公司 关于公司申请新型政策性金融工具及向控股子公司增 资的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

投资标的名称	芯联先锋集成电路制造 (绍兴) 有限公司
投资金额(万元)	180, 000
投资进展情况	☑完成 □终止 □交易要素变更
特别风险提示(如有)	无

一、基本情况

基于整体战略发展规划和实际经营需求,看好功率模组应用配套所需各类芯片的市场发展,以及新型政策性金融工具的落实和推进的重要契机,芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称"公司")拟申请不超过人民币 18 亿的政策性金融工具,用于保障控股子公司芯联先锋集成电路制造(绍兴)有限公司(以下简称"芯联先锋") "三期 12 英寸集成电路数模混合芯片制造项目"的建设。公司于 2025 年 10 月 16 日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司拟申请新型政策性金融工具事项及全资子公司为公司担保的议案》和《关于公司向控股子公司增资的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《芯联集成电路制造股份有限公

司关于拟申请新型政策性金融工具事项及全资子公司为公司担保的公告》(公告编号: 2025-053)和《芯联集成电路制造股份有限公司关于公司向控股子公司增资的公告》(公告编号: 2025-054)。

二、本次申请新型政策性金融工具暨向控股子公司增资完成情况

公司已于近日与国开新型政策性金融工具有限公司签署了《国开新型政策性金融工具股东借款合同》,金额为人民币 18 亿元,期限 5 年,作为芯联先锋"三期 12 英寸集成电路数模混合芯片制造项目"的资本金投入。同时,公司聘请了符合《中华人民共和国证券法》规定的金证(上海)资产评估有限公司以 2025 年 6 月 30 日为评估基准日,采用资产基础法和市场法,按照必要的评估程序,对芯联先锋集成电路制造(绍兴)有限公司股东全部权益价值进行了评估,并出具了金证评报字(2025)第 0583 号资产评估报告,资产评估价值为 1,284,500.00 万元。

根据公司与芯联先锋及芯联先锋的其他股东签署《投资协议》,以评估报告的评估值为基础,并经各方协商,确定本次增资价格为 1.11 元/注册资本。本次增资于投资款支付之日完成交割,自交割日起公司持有芯联先锋新增注册资本,并享有新增注册资本的各项权利。后续各方将依法办理本次增资所涉及投资款支付及工商变更登记事宜。

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

公司本次增资的资金来源为新型政策性金融工具,政策性金融工具资金期限 长、利率低,能有效降低公司的整体资金成本,减轻公司融资负担,符合国家金融重点支持政策。

本次增资巩固了上市公司对子公司的控制权,有利于公司的长远发展,符合 公司整体战略规划,有助于公司扩大市场规模,提升市场竞争力。

本次增资预计不会对公司的正常生产及经营产生不利影响,不存在损害公司 及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会 2025年10月28日